

## 承诺函

本承诺函由厦门华侨电子股份有限公司（“本公司”，“上市公司”）于 2018 年 2 月 11 日签署。

鉴于，上市公司拟以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买福建福光股份有限公司（“福光股份”）合计 61.67% 的股份（“本次重组”）。

本公司现说明并承诺如下：

1、本公司参与本次重组是本公司的真实意思表示，并将严格履行重组相关协议，在符合法律法规规定的情况下，推动重组的进行。本公司与交易对方已就本次重组达成一致意见，本次重组不存在障碍。

2、本公司为本次重组而向上市公司及参与本次重组的各中介机构所提供的所有资料、信息和作出的声明、承诺、确认及说明等均为真实、准确、完整和及时的，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人员经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的事项。

4、本公司承诺对所提供、披露资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司的投资者或者参与本次重组的中介机构造成损失的，将依法承担赔偿责任。

本公司承诺并保证，本公司出具的本承诺函所列内容均真实、合法、有效，不存在虚假陈述或误导性陈述。本承诺函自本公司盖章后立即生效。

特此承诺

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《承诺函》之签署页)

厦门华侨电子股份有限公司 (盖章)

